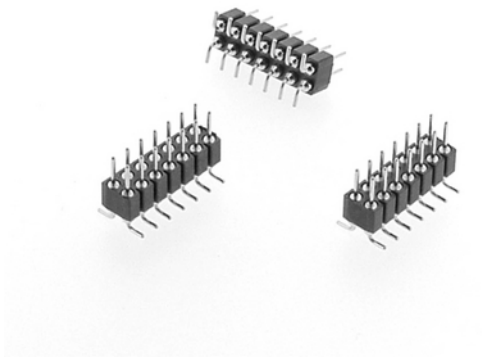
7354

SMT-Präzisions-Stiftleisten RM 2,00mm, stehend, 1-/2-reihig

SMT Precision Pin Headers, 2.00mm Pitch, Vertical, Single/Double Row

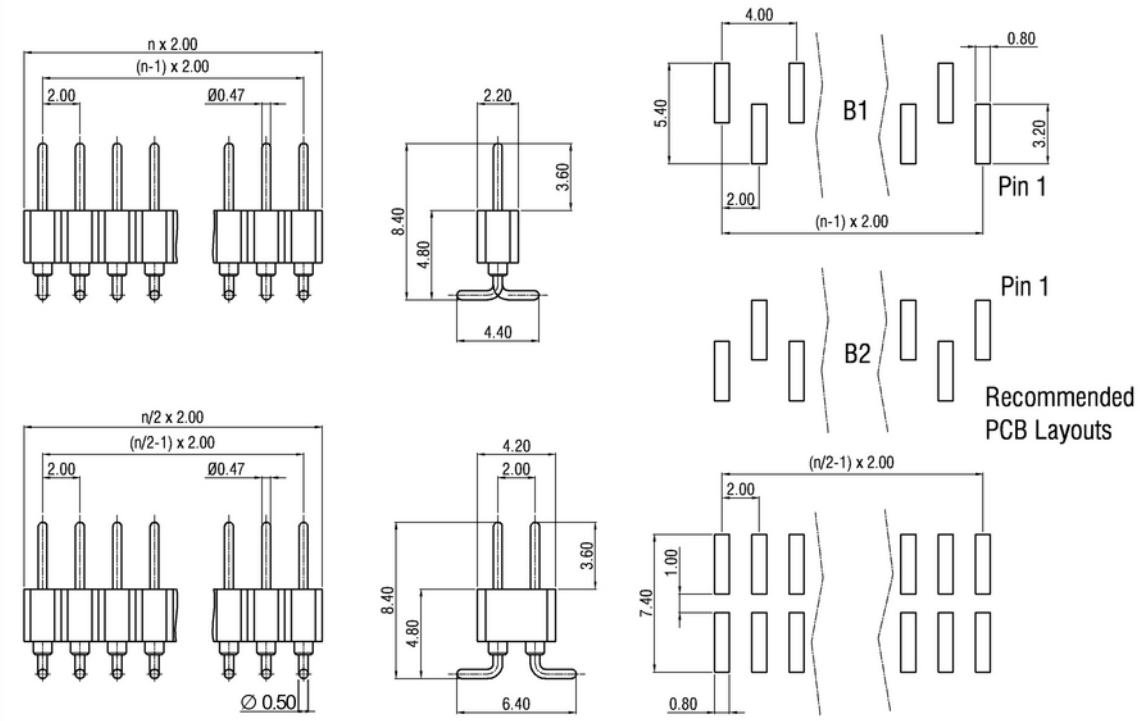
Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Rundkontakt Ø0,47mm, Kupferlegierung
Contact Material	*Ø0.47mm round contact, copper alloy*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)*
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	*IEC 60512-12A*
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	*< 10mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	*> 1000MΩ*
Spannungsfestigkeit	$1kV_{RMS}$
Test Voltage	*$1kV_{RMS}$*
Nennstrom	3A
Current Rating	*3A*
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	*-55°C ... +125°C*
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	*Reflow soldering*



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Mate with Female Headers:
7452



Series	*Contacts**	*Rows**	*Plating**	*Packaging**
7354	**050**	**11**	**00**	**PPST**
	003-050 Einreihig *Single row* **004-100** Zweireihig *Double row*	**11** Einreihig B1 *Single row B1* **12** Einreihig B2 *Single row B2* **20** Zweireihig *Double row*	**00** Vergoldet *Gold plated* **10** 0,25µm Gold *0.25µm gold plated* **50** Verzinnt *Tin plated*	**ST** **PPST** **PPTR**

Lieferformen / *Packaging Options:*
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / *In tubes w/o Pick&Place-Pad*
PPST In Stangen mit P&P-Pad / *In tubes with P&P-Pad*
PPTR Tape & Reel / *Tape & Reel*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

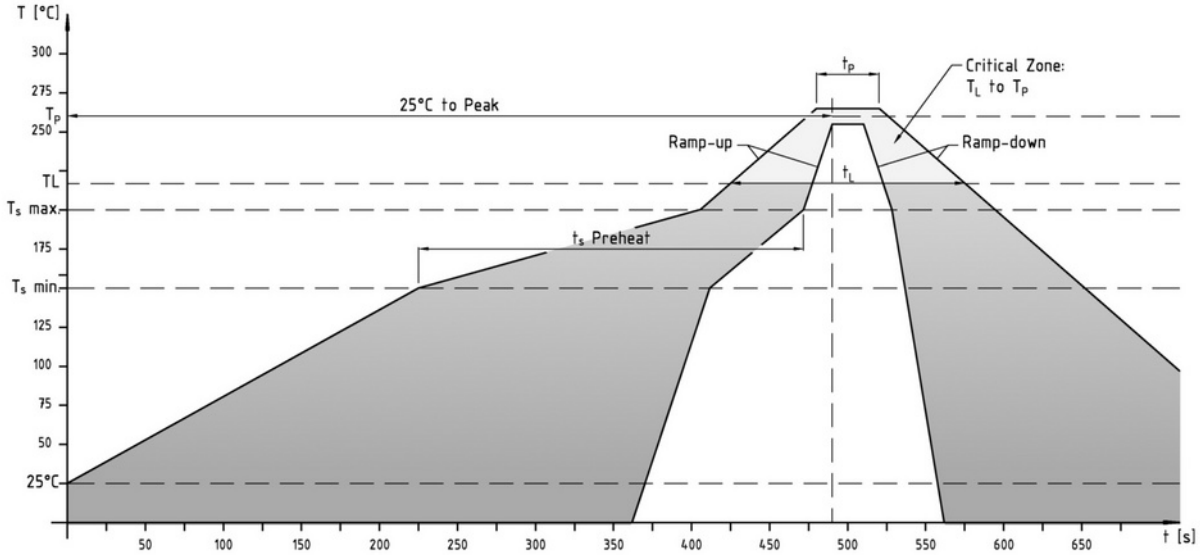
E-MAIL sales@wppro.com
WEBSITE www.wppro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren
Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung
Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J_STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150°C
Temperatur Maximum $T_S$max	200°C
Dauer $T_S$min - $T_S$max	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_S$max - T_P	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_P$max - $T_S$min	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150°C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200°C*
Duration $T_S$min - $T_S$max	*60-180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217°C*
Duration above T_L	*60-180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max - T_P	*max. 3°C / s*
Peak Temperature T_P	*260°C ±5*
Duration Peak Temperature	*20-40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max - $T_S$min	*6°C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*Max. 8min*